

【会員限定】2024年度第4回 WBG実装WG研究会

【開催日】2025年3月3日(月)13:30～19:00

【会場】大阪大学 産業科学研究所 インキュベーション棟1階
講義室(I-117)

大阪大学産業科学研究所F3D協働研究所研究所におけるF3D実装コンソーシアム活動におきまして、2024年度期における当該コンソーシアム活動傘下のWBG実装WG (WGB-WG)研究会を下記の内容で開催いたします。

【プログラム】 【次世代パワー半導体パッケージング技術開発】

13:30-13:40 開会挨拶

13:40-14:30 講演①

「次世代パワーモジュールの電気絶縁信頼性・材料開発・絶縁技術の動向」(仮題)

九州工業大学大学院 工学研究院 教授 小迫 雅裕 氏

ハイブリッド開催
(阪大産研+ZOOM)

14:30-15:30 講演②

「ITRIが主導する新パワー半導体パッケージプロジェクト」(仮題)

リモート講演

台湾工業技術研究院(ITRI)

パワー半導体開発グループリーダー Tao-Chih Chang 氏

15:30-15:50 休憩・講師との名刺交換会

15:50-16:40 講演③

「力学シミュレーションを活用した高耐熱パワー半導体モジュールの信頼性設計・評価」(仮題)

株式会社 先端力学シミュレーション研究所 技術開発本部

基盤技術開発室

室長 前澤 祐 氏

17:00-19:00 講演者を交えた意見交換会

申し込みQRコード



申し込みURL: https://docs.google.com/forms/d/14Bkk-toxQtTr0jR8Afz5zEqmo5MDFjyLk_XkkdgpTyE/edit

会場アクセス Web: <https://www.sanken.osaka-u.ac.jp/access/>

申し込み・問い合わせ 大阪大学 産業科学研究所 F3D実装協働研究所 WBG-WG事務局
(TEL/FAX: 06-6879-4295/E-mail: f3d@sanken.osaka-u.ac.jp)

主催: 大阪大学 産業科学研究所 F3D実装協働研究所

後援: 一般財団法人大阪大学産業科学研究協会